

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 12 月 6 日(06.12.2012)



(10) 国際公開番号

WO 2012/165423 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 63/00 (2006.01) C08K 3/36 (2006.01)
C08J 5/24 (2006.01) C08K 5/3445 (2006.01)
C08K 3/00 (2006.01) C08L 79/04 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/063740
- (22) 国際出願日: 2012 年 5 月 29 日(29.05.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-121923 2011 年 5 月 31 日(31.05.2011) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 三菱
瓦斯化学株式会社(MITSUBISHI GAS CHEMICAL
COMPANY, INC.) [JP/JP]; 〒1008324 東京都千代田
区丸の内二丁目 5 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 小柏 尊明
(OGASHIWA Takaaki) [JP/JP]; 〒1258601 東京都葛
飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会
社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 高橋 博史
(TAKAHASHI Hiroshi) [JP/JP]; 〒1258601 東京都葛
飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会
社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 宮平 哲郎
(MIYAHIRA Tetsuro) [JP/JP]; 〒1258601 東京都葛
飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会
社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 加藤 禎啓
(KATO Yoshihiro) [JP/JP]; 〒1258601 東京都葛飾区
新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社
東京テクノパーク内 Tokyo (JP).
- 新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社
東京テクノパーク内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 勝沼 宏仁, 外(KATSUNUMA Hirohito et
al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番
3 号 富士ビル 3 2 3 号 協和特許法律事務所
Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS,
JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST,
SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR,
NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告(条約第 21 条(3))

(54) Title: RESIN COMPOSITION, PREPREG AND LAMINATE

(54) 発明の名称: 樹脂組成物、プリプレグ及び積層板

(57) Abstract: [Problem] To provide a resin composition for a printed wiring board, a prepreg, a laminate, and a metal foil clad laminate, the resin composition retaining a high level of flame retardance without using a halogenated compound or a phosphorus compound, and having a low coefficient of water absorption, a high glass transition temperature, and a high modulus of elasticity at high temperatures. [Solution] This resin composition comprises a specific maleimide compound (A), a cyanic acid ester compound (B), a non-halogen epoxy resin (C) and an inorganic filler (D).

(57) 要約: [課題] ハロゲン化合物やリン化合物を使用せずに高度の難燃性を保持し、低吸水性、かつガラス転移温度が高く、高温時の弾性率が高いプリント配線板用樹脂組成物、プリプレグ、積層板、及び金属箔張積層板を提供する。 [解決手段] 本発明による樹脂組成物は、特定のマレイミド化合物(A)と、シアン酸エステル化合物(B)と、非ハロゲン系エポキシ樹脂(C)と、無機充填材(D)とを含む。



WO 2012/165423 A1